

# Epochcluster STR25LM

開発中 PR商品

エポククラスター STR25LM

## コイル封止用低温硬化エポキシ成形材料

ポッティングからトランスファー成形でコストダウン

- ・高サイクル
- ・作業性向上、工程簡素化
- ・低温成形、良流動
- ・Tg、硬化温度
- ・お客様のご用途によりカスタマイズ

注型成形 → トランスファー成形により生産性・作業性向上  
成形後、次工程(保管、運送、アフターキュア)での取り扱いが楽  
ポピン、電気素子にダメージを与えず成形、線間充填  
Tg 140℃~150℃(TMA法)、推奨成形温度 145℃  
本材料は開発ベースの一例でありお客様用途にカスタマイズ

### トランスファー成形

トランスファー成形材料なので注型成形に比べ

- ・短時間成形が可能(数分~10分)
- ・工程簡素化・作業性が良好  
(ポピン・コイル被覆・電線被覆・制御ICなど)
- ・次工程にすぐ取り掛かることができ生産性向上
- ・BMC(不飽和ポリエステル)よりも信頼性向上

などの優位性があります。

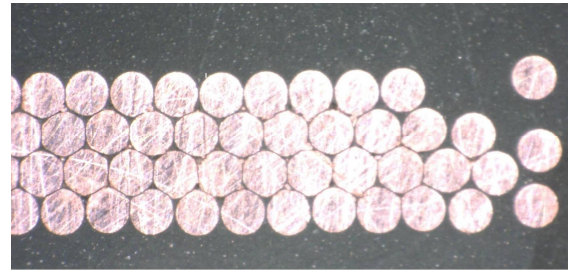


図1 コイル封止図 (銅線 φ0.5 mm)

### 低温成形・低粘度

- ・耐熱の低いモールド対象も成形可能  
(ポピンの変形や電気素子へのダメージを防止)
- ・線間充填可能
- ・粘度 10~20 Pa・s、ゲルタイム 70 s~120 s  
(ポピン・コイル被覆・電線被覆・制御ICなど)
- ・推奨硬化温度 145℃



図2 封止アプリケーション例

### アプリケーション

モーター、リアクタンス、トランス、プローブ、ソレノイドなど各種コイル類の絶縁、固定、制震用途の低温封止に使用できます。

### 基礎特性

お客様のご要望で熱線膨張のマッチング、硬化時間など調整可能です。

表1 基礎特性

曲げ強度	(MPa)	81
曲げ弾性率	(GPa)	5~8
線膨張率(MD/TD)	(ppm/k)	32~49
Tg	℃	140~150
絶縁破壊電圧	kV/mm	14~17

# Epochcluster STR25LM

エポクラスター STR25LM

## 基礎物性

特性		試験方法	単位	STR31c
物理特性	比重	JIS K7112	—	1.60~1.65
	成形収縮率 (MD/TD)	—	%	—
	粘度 (145℃)	クラスター法	Pa・s	10~20
機械特性	曲げ強度	ISO 178	MPa	81
	曲げ弾性率	ISO 178	GPa	5~8
	アイゾッド衝撃値 (ノッチ無し)	JIS K7110	kJ/m <sup>2</sup>	—
熱特性	線膨張係数 (MD/TD)	TMA法	ppm/k	32~49
	ガラス転移温度	TMA法	℃	140~150
	推奨硬化温度	クラスター法	℃	145
電機特性	絶縁破壊電圧	JIS K6911	kV/mm	15~17
	表面抵抗率	JIS K6911	Ω	10 <sup>14</sup> ~10 <sup>15</sup>
	体積抵抗	JIS K6911	Ωm	10 <sup>13</sup> ~10 <sup>14</sup>
Ωcm			10 <sup>15</sup> ~10 <sup>16</sup>	

上記データは射出成形時の測定値であり、材料規格に対する保証値ではありません

### クラスターテクノロジー 株式会社

営業・マーケティング本部

本社 〒577-0836 大阪府東大阪市洪川町4-5-28

TEL: 06-6726-2711 FAX: 06-6726-2715

e-mail: osaka-tech@cluster-tech.co.jp

東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-5

新日本橋長岡ビル 9階

TEL: 03-5642-6183 FAX: 03-5642-6185

URL: <http://www.cluster-tech.co.jp>